



life.augmented

新聞稿



意法半導體推出通過最新產業標準認證之5G M2M嵌入式SIM卡

全球首款獲得GSMA eSA (安全保障) 認證的產品

【台北訊，2022年7月20日】— 服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體 (STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM) 新推出ST4SIM-201機器對機器通訊 (M2M) 嵌入式SIM卡 (eSIM)。此產品符合最新5G網路連線、M2M安全規範，及靈活遠端啟動管理標準。

ST4SIM-201符合ETSI / 3GPP標準16版，除了可連接至5G獨立組網 (SA)，還能連到3G、4G網路，以及低功耗廣域 (LPWA) 網路技術，如：機器長期演進 (LTE-M) 網路、窄頻物聯網 (NB-IoT)。

ST4SIM-201通過了最新的GSMA eUICC M2M規範之SGP.02 4.2版認證，能夠遠端進行個人設定，以簡化啟動和維護。此新產品是首款使用SGP.05 eUICC Protection Profile規範1.1版，實現GSMA eUICC安全保證 (eSA) 的SIM卡。有了此SIM卡，使用者無需實體操作就可以透過遠端選擇屬意的運營商，以簡化物流配送，提升應用靈活性，且有助於降低持卡之生命週期的成本。此外，使用者還可以使用SGP.02規範4.2版中規定的測試，設定文件和緊急設定檔。

工業級的ST4SIM-201適用於物聯網應用，及任何需要蜂窩連線的設備，包含智慧電表、資產追蹤器、健康狀況監測器、保全裝置、遙測設備、安全系統等「智慧連網物件」。

此新產品遵守ETSI規範，確保晶片支援M2M應用效能，其中包括省電模式 (Power-Saving Mode，PSM)

及延長不連續接收 (Extended Discontinuous Reception · eDRX) 模式，充分利用閒置模式。ST4SIM-201亦支援ETSI規定之掛起 / 恢復命令，以提升電源管理效率。

除了標準的2FF、3FF和4FF插卡外，提供多種封裝尺寸滿足不同客戶需求，包括5mm x 6mm DFN8雙扁平無引線封裝和晶圓級晶片封裝 (WLCSP) 。

更多資訊，請造訪：www.st.com/st4sim。

關於意法半導體

意法半導體擁有48,000名半導體技術的創造者和創新者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。身為一家半導體垂直整合製造商 (IDM)，意法半導體與逾二十萬家客戶、數千名合作夥伴一起研發產品和解決方案，共同建立生態系統，協助利益關係人因應各種挑戰和新機會，滿足世界對永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電力和能源管理更高效，物聯網和互聯技術應用更廣泛。意法半導體承諾將於2027年實現碳中和。詳情請瀏覽意法半導體公司網站：www.st.com。